

2011-2015年中国铜箔行业 深度调研与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国铜箔行业深度调研与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jinshu1104/J043802QJM.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2011-04-21

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 <http://www.bosidata.com>

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国铜箔行业深度调研与投资前景研究报告》共十章。首先介绍了世界铜箔产业运行态势、中国铜箔市场运行环境等，接着分析了中国铜箔市场发展的现状，然后介绍了中国铜箔市场竞争格局。随后，报告对中国铜箔行业做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国铜箔市场发展前景与投资预测。您若想对铜箔产业有个系统的了解或者想投资铜箔行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

铜箔由铜加一定比例的其它金属打制而成。铜箔是一种阴质性电解材料，沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔，它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层，接受印刷保护层，腐蚀后形成电路图样。Copper mirror test(铜镜测试)：一种助焊剂腐蚀性测试，在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。

第一章 2010-2011年世界铜箔产业运行态势分析

第一节 2010-2011年世界铜箔产业运行环境综述

第二节 2010-2011年世界铜箔业运行概况

一、世界电解铜箔业发展与演进

二、世界铜箔生产工艺研究

三、国外PCB用铜箔技术新发展

四、全球压延铜箔市场动态分析

第三节 2010-2011年世界主要铜箔生产国家运行分析

一、美国

二、日本

三、韩国

第四节 2011-2015年世界铜箔市场发展趋势分析

第二章 2010-2011年世界压延铜箔重点企业运行浅析

第一节 Nippon Mining（日本）

第二节 福田金属Fukuda、Olin brass（美国）

第三节 Hitachi Cable（日本）

第四节 Microhard（日本）

第三章 2010-2011年中国铜箔市场运行环境分析

第一节 2010年中国宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2011年中国宏观经济发展预测分析

第二节 2010-2011年中国铜箔市场政策环境分析

- 一、锂离子用铜箔技术标准
- 二、中国铜箔基础板出口退税政策调整
- 三、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

第三节 2010-2011年中国铜箔市场社会环境分析

第四章 2010-2011年中国铜箔市场发展现状分析

第一节 2010-2011年中国铜箔业发展动态

- 一、铜箔行业发展规模分析
- 二、铜箔产业发展机遇分析
- 三、铜箔产品价格走势分析

第二节 2010-2011年中国铜箔技术水平分析

- 一、新CO₂雷射直接铜箔加工技术
- 二、中国攻克18微米铜箔技术
- 三、铜箔分离技术

第三节 2010-2011年中国铜箔业发展中存在的问题

第五章 2010-2011年中国铜箔市场运营情况分析

第一节 2010-2011年中国铜箔业市场运行分析

- 一、中国铜箔市场供给情况分析
- 二、中国铜箔市场消费情况分析
- 三、国内铜箔需求形势分析

第二节 2010-2011年中国铜箔市场运营动态分析

- 一、中科英华万吨电解铜箔项目力争年内投产
- 二、梅雁铜箔被列为国家重点新产品

三、松下电工开发出传输低损耗的LCP柔性覆铜箔板

第六章 2008-2010年中国铜箔制造行业主要数据监测分析

第一节 2008-2010年中国铜箔制造行业总体数据分析

一、2008年中国铜箔制造行业全部企业数据分析

二、2009年中国铜箔制造行业全部企业数据分析

三、2010年中国铜箔制造行业全部企业数据分析

第二节 2008-2010年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

一、2008年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

二、2009年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

三、2010年中国铜箔制造行业不同规模企业数据分析

第三节 2008-2010年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

一、2008年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

二、2009年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

三、2010年中国铜箔制造行业不同所有制企业数据分析

第七章 2010-2011年中国铜箔市场竞争格局分析

第一节 2010-2011年中国铜箔市场竞争现状分析

一、铜箔市场技术竞争

二、铜箔市场综合竞争力分析

三、铜箔成本竞争分析

第二节 2010-2011年中国铜箔行业集中度分析

一、铜箔市场集中度

二、铜箔行业区域集中度

第三节 2010-2011年中国铜箔业竞争策略分析

第八章 2010-2011年中国铜箔行业内优势企业竞争力分析

第一节 中科英华

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 海亮股份

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 鑫科材料

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 广东超华科技股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第六节 惠州合正电子科技有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第七节 松下电工电子材料(广州)有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第八节 四会市达博文实业有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九节 梅州市威华铜箔制造有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十节 广东梅县梅雁电解铜箔有限公司

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第九章 2010-2011年中国PCB行业发展状况分析

第一节 2010-2011年中国印刷电路板行业的总体概况

- 一、中国印刷电路板行业增长速度远高于行业平均速度
- 二、我国将成为世界最大产业基地
- 三、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
- 四、低端PCB（4层以下）竞争比较充分，集中度较低
- 五、高端PCB（HDI等）处于供不应求的状态

第二节 2010-2011年我国印刷电路板市场发展现状分析

- 一、印刷电路板市场生产结构分析
- 二、印刷电路板市场需求特点分析
- 三、印刷电路板市场技术发展分析

第三节 2010-2011年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

- 一、产品集中于中低端成本转嫁能力弱
- 二、应对专利和新环保政策
- 三、内地本土所贡献的产出值比例很小

第四节 2010-2011年中国印刷电路行业发展对策分析

第十章 2011-2015年中国铜箔市场发展前景与投资预测分析

第一节 2011-2015年中国铜箔市场发展前景展望

- 一、电子级铜箔尤其是高性能箔市场看好
- 二、铜箔产品前景光明
- 三、中国电解铜箔市场前景趋好

第二节 2011-2015年中国铜箔产业发展趋势前瞻

- 一、电解铜箔业的发展趋势
- 二、铜箔业技术发展趋势

第三节 2011-2015年中国铜箔市场走势预测

- 一、铜箔供需预测分析
- 二、铜箔价格走势预测
- 三、铜箔进出口贸易预测分析

第四节 2010-2011年中国铜箔投资环境分析

一、中国铜矿资源产业投资政策解读

二、中国宏观经济环境分析

第五节 2011-2015年中国铜箔市场投资机会分析

一、铜箔行业成为新的投资热点

二、铜箔细分产品投资机会分析

三、铜箔产业相关政策调整投资机会分析

第六节 2011-2015年中国铜箔市场投资风险分析

第七节 专家投资建议

图表目录：（部分）

图表：2005-2010年国内生产总值

图表：2005-2010年居民消费价格涨跌幅度

图表：2010年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2005-2010年国家外汇储备

图表：2005-2010年财政收入

图表：2005-2010年全社会固定资产投资

图表：2010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2010年固定资产投资新增主要生产能力

图表：中科英华主要经济指标走势图

图表：中科英华经营收入走势图

图表：中科英华盈利指标走势图

图表：中科英华负债情况图

图表：中科英华负债指标走势图

图表：中科英华运营能力指标走势图

图表：中科英华成长能力指标走势图

图表：海亮股份主要经济指标走势图

图表：海亮股份经营收入走势图

图表：海亮股份盈利指标走势图

图表：海亮股份负债情况图

图表：海亮股份负债指标走势图

图表：海亮股份运营能力指标走势图

图表：海亮股份成长能力指标走势图

图表：鑫科材料主要经济指标走势图

图表：鑫科材料经营收入走势图

图表：鑫科材料盈利指标走势图

图表：鑫科材料负债情况图

图表：鑫科材料负债指标走势图

图表：鑫科材料运营能力指标走势图

图表：鑫科材料成长能力指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司主要经济指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司经营收入走势图

图表：广东超华科技股份有限公司盈利指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司负债情况图

图表：广东超华科技股份有限公司负债指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司运营能力指标走势图

图表：广东超华科技股份有限公司成长能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司主要经济指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司经营收入走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司盈利指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债情况图

图表：山东金宝电子股份有限公司负债指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司运营能力指标走势图

图表：山东金宝电子股份有限公司成长能力指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司主要经济指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司经营收入走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司盈利指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司负债情况图

图表：惠州合正电子科技有限公司负债指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司运营能力指标走势图

图表：惠州合正电子科技有限公司成长能力指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司主要经济指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司经营收入走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司盈利指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司负债情况图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司负债指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司运营能力指标走势图

图表：松下电工电子材料(广州)有限公司成长能力指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司主要经济指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司经营收入走势图

图表：四会市达博文实业有限公司盈利指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司负债情况图

图表：四会市达博文实业有限公司负债指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司运营能力指标走势图

图表：四会市达博文实业有限公司成长能力指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司主要经济指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司经营收入走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司盈利指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司负债情况图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司负债指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司运营能力指标走势图

图表：梅州市威华铜箔制造有限公司成长能力指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司主要经济指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司经营收入走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司盈利指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司负债情况图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司负债指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司运营能力指标走势图

图表：广东梅县梅雁电解铜箔有限公司成长能力指标走势图

图表：2011-2015年中国铜箔供需预测分析

图表：2011-2015年中国铜箔价格走势预测

图表：2011-2015年中国铜箔进出口贸易预测分析

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinshu1104/J043802QJM.html>